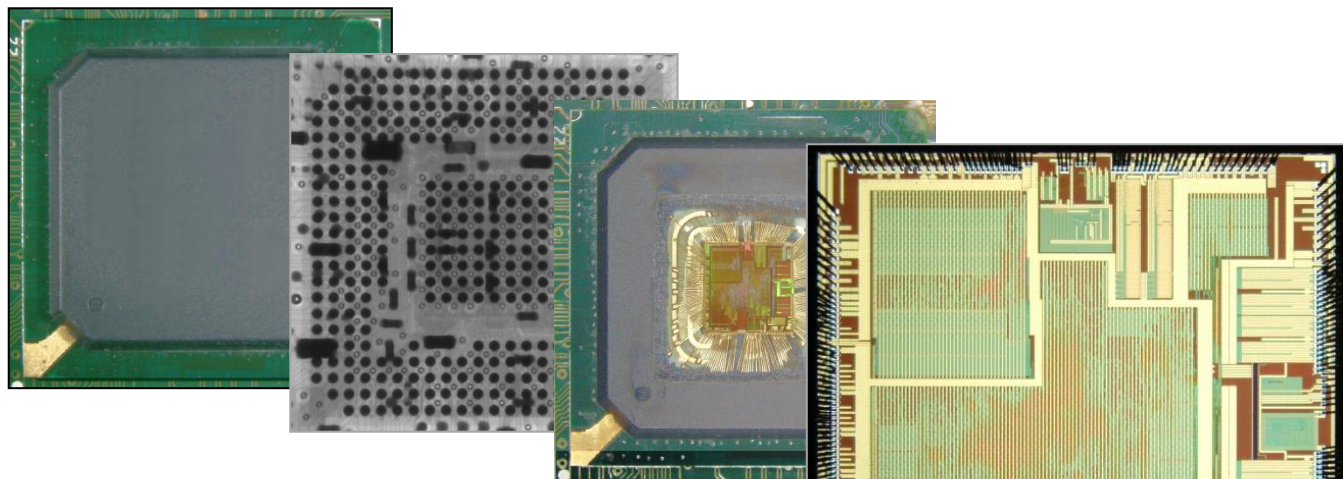


パッケージ開封～エッチング解析



内藤電誠工業(株)

パッケージを開封し、チップやワイヤ等の観察、エッチングによる界層観察などICやLSIの解析を行います。

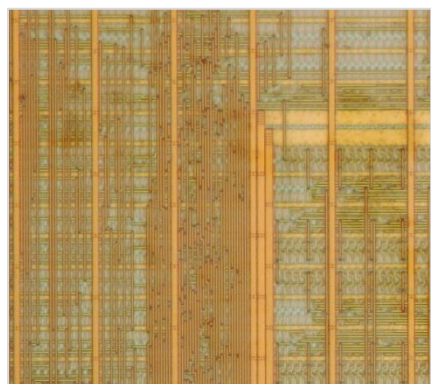


故障状態を把握する不良解析や製品のプロセス調査、潜在的欠陥調査等の良品解析など、お客様の目的にお応えします。

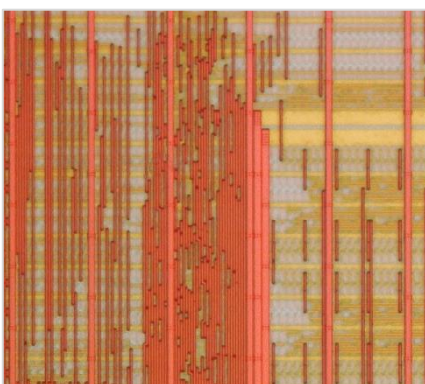


**ドライエッチング装置をリプレイス！
ファインプロセスLSIや多層配線にも対応した
エッチングで広範囲の界層を観察。**

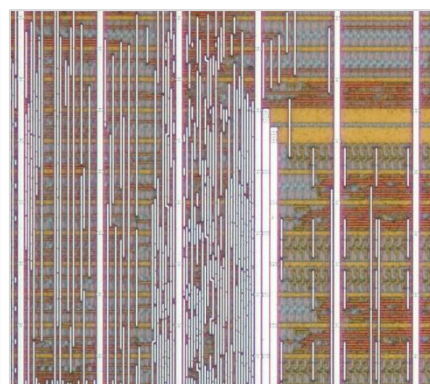
パッケージ開封後、ドライエッチング装置でチップ表面のポリイミド膜を除去。
さらに酸化膜～Ti系のバリアメタルまでエッチング。



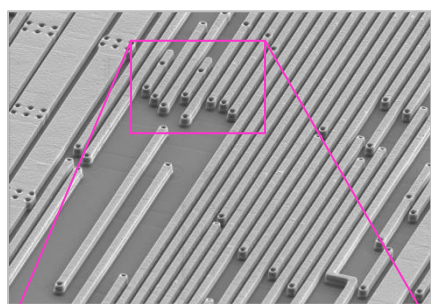
ポリイミド膜あり



ポリイミド膜除去後



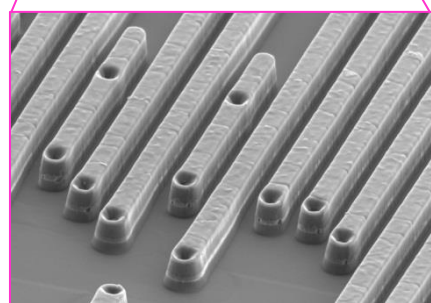
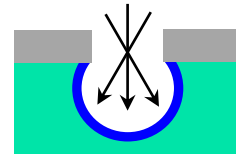
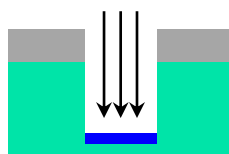
SiO₂～Ti系バリアメタルまで
エッチング後



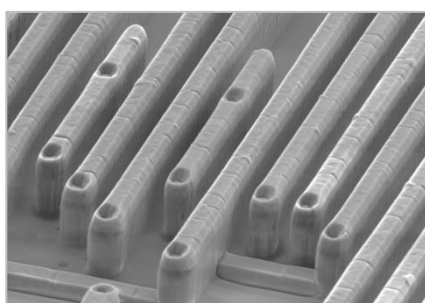
優れた異方性のドライエッチングにより多層配線の構造を観察。

異方性エッチングのイメージ

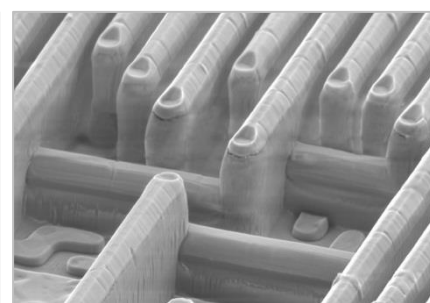
等方性エッチングのイメージ



最上層配線観察



上2層配線観察



上3層配線観察

故障解析用ドライエッチング装置 ES373(NSC製)

ファインプロセスで設計されたLSIのための故障解析用ドライエッチング装置。
多層配線にも十分対応できる性能を有しています。

- ・ 高周波出力 : 20～100W
- ・ 選択ガス : CF₄/O₂
- ・ ステージ寸法 : 50mm φ
- ・ ステージ温度 : 30～50℃



内藤電誠工業株式会社 評価解析事業部

213-0011 川崎市高津区久本3-9-25

TEL: 044-811-5496

FAX: 044-850-5851

<https://www.lab.ndk-grp.co.jp/>